

قسم الحاسوب

الأكاديمية الليبية
بنغازى



* * * * *

-:

مقارنة بين أنواع المعالجات

-:

المعالج هو العقل المدبر للحاسب ، يستقبل الأوامر ويعالجها ويعطي نتائجها على شكل معلومات نستفيد منها ، من الناحية دية هو قطعة مربعة الشكل وخفيفة الوزن يخرج من أسفلها عدد من (pins) التي تسمح للمعالج بالاتصال مع مقبس المعالج على اللوحة وذلك لتبادل البيانات بينه وبين اللوحة الأم ، يتكون في الأصل من ملايين لترانزستورات المجموعة في شريحة صغيرة جدا من السليكون ، وهذه الشريحة تثبت من داخلها وذلك لإيصالها

التي تكون أسفل غلاف المعالج. تتألف المعالجات من عدد كبير جداً من بل هي ترانزستورات موزعة في شكل مجموعات داخل المعالج لتقوم كل مجموعة منها بنوعية معينة من الأعمال ، فمثلاً أحد المجموعات مخصصة للمقارنة بين الأرقام و أخرى لاتخاذ القرارات في حالة معينة وهكذا ، وفي كل مجموعة تختلف عدد وطريقة تجمع مما يؤثر على وظيفتها ، ويستطيع الحاسب باستخدام هذه المجموعات المختلفة بشكل مدروس ومنظم أن يقوم بكل العمل الذي يطلب منه.

إن كل "مجموعة" من هذه المجموعات تسمى "بوابة منطقية" وتختلف البوابات المنطقية بحسب الوظيفة التي تؤديها وعدد ترانزستورات التي تحتويها. وتصنيع المعالج ما هو إلا وضع هذه المجموعات وربطها ببعضها بالشكل المطلوب

والترانزستور بحد ذاته هو وحدة صغيرة جداً تسمح بمرور التيار الكهربائي من خلالها بمقدار يختلف باختلاف التيار الداخل لها أي أنها تسمح بالتحكم بشدة تيار كهربائي حسب شدة تيار كهربائي آخر ، فهي كالمفتاح الكهربائي ، وباستخدام هذه الوحدة الصغيرة (الترانزستور) يمكننا تنظيمها لتكوين وحدات ذات وظيفة معينة تختلف باختلاف ترتيب داخلها ، وبذلك يمكننا تكوين أنواع لا نهائية من الوحدات وكلما وتنسيق هذه التي تتكون منها الـ IC كلما كان بإمكانها تأدية وظائف أكثر تعقيداً .

هيكلية :

يوجد داخل المعالج ملايين التي تؤدي بمجملها للقيام بعمل المعالج وهذه موضوعة كلها في مساحة صغيرة جداً أي أنها محشورة وبين الواحدة والأخرى مساحة قليلة (لا ترى بالعين المجردة) وهذه الوحدات موصلة مع بعضها البعض بأسلاك صغيرة جداً تضمن تدفق البيانات بين ، ويقاس سماكة هذه الأسلاك بالمايكرون ، وسماكة هذه الأسلاك هو الذي يحدد معمارية المعالج ، وكلما كانت معمارية المعالج أصغر كلما كان استهلاك الطاقة أقل و كانت الحرارة الناتجة من المعالج أقل مما يخفف من مشاكل التبريد وكذلك يمكننا المعمارية الأصغر من استخدام

فولتية أقل للتيار المار في هذه الأسلاك.

1. Intel Core core 2 duo Processor

ومن مميزات هذا المعالج

أولاً: سرعة أقل لكن أداء أعلى

تحتوي هذه العائلة على العديد من المعالجات، لذلك تصنف من المعالجات متعددة
2 تتراوح سرعاتها من 1.8 2.66 جيجا هرتز

ثانياً : بنية Core Architecture الجديدة كلياً :

وهو أحد أكبر التغييرات التي أجرتها إنتل حيث استخدمت إنتل تقنية – بنية داخلية- جديدةً

Core 2 وسميت هذه البنية الجديدة ببنية Core Architecture

تختلف تماماً عن البنية الداخلية المستخدمة في Pentium D، حيث من المعروف أن معالج

Pentium D يحتوي على معالجات من نوع Pentium 4 في نفس الشريحة وبالتالي فهو

يعتمد على البنية القديمة Net Burst وهي بنية قديمة جداً لم تتغير منذ عدة سنوات.

ونلاحظ أنه في البنية الجديدة تستطيع كل وحدة معالجة، معالجة أربع تعليمات في نفس

اللحظة بينما كان هذا العدد 3 تعليمات في البنية السابقة، وهو ما سمي بميزة Intel®

Wide Dynamic Execution وهذا يعني زيادة في سرعة التنفيذ بمقدار 33%

البنية القديمة! مما يقلل الحاجة لسرعات أعلى، فعندما نقول سرعة معالج هي 1 جيجا

فهذا يعني انه يستطيع أن ينجز مليار نبضة ساعة في الثانية ولكن في البنية القديمة تستطيع

تنفيذ ثلاثة تعليمات في كل نبضة ساعة بينما تستطيع في البنية الجديدة تنفيذ 4 تعليمات

وبالتالي وباعتماد هذه الميزة فقط نستنتج أن معالج كور 2 جيجا هرتز أقوى من

معالج بنتيوم دي دوال كور بسرعة 2.66 جيجا هرتز لكن بالطبع هناك العديد من المزايا

كلما ازدادت سرعة نبضات الساعة في الدقيقة كلما استهلك المعالج طاقة أكبر، وأطلق

حرارة أكبر، وبالتالي مع تخفيض سرعة المعالج يصبح المعالج أكثر برودة، وأقل استهلاكاً

للطاقة، وبالتالي يصبح جهاز الكمبيوتر أكثر استقراراً خصوصاً في البيئات الحارة، وكذلك

يستهلك طاقة كهربائية أقل وهذا يعني الكثير لشركات تحتوي مكاتبها على الآلاف من أجهزة

الكمبيوتر.

ولذا فإن معيار الأداء كل وات أو ما يسمى Performance per Watt معيار هام جداً

وتتسابق على الفوز به كل من AMD Intel AMD هي الرائدة في هذا المجال

حتى أطلقت إنتل تقنية Core 2.

ثالثاً: الذاكرة الداخلية الكاش وتقنية Intel® Advanced Smart Cache

نلاحظ أنه بالنسبة لمعالجات Pentium D فيذكر دائماً ذاكرة كاش 4 ميجا، وهذا يعني 2 ميجا لكل نواة داخلية، أما في المعالج الجديد Core 2 Duo فيذكر أن الذاكرة الكاش 4 ميجا، وهذا بسبب أنه في البنية القديمة، لكل نواة ذاكرة خاصة بها ولا تستطيع النواة الأخرى الاستفادة منها أبداً، أما في معالجات الكور 2 فتتشارك النواتين بالذاكرة ويستفيدون منها، وهذا يضيف كثيراً للأداء ويعطي ديناميكية وحرية في المعالجة لكل نواة بحسب الحاجة وضغط العمل عليها، ويقلل من أوقات الانتظار.

رابعاً: Intel® Intelligent Power Capability

وهي تقنية متفوقة حقاً، حيث أن المعالج يتكون من عدة وحدات معالجة كل منها يقوم بمعالجة وتنفيذ نوعية معينة من التعليمات أو مرحلة معينة من العملية، وبالتالي يستطيع 2 إطفاء الوحدات الغير المستخدمة حالياً وذلك للتخفيف من استهلاك الطاقة حتى في فترات الضغط، فمادام المعالج غير محتاج لوحدة معينة فسوف يتم إطفائها، وبالطبع تشغيلها وقت الحاجة.

خامساً: Intel Speed Step Technology

وهي تقنية طرحتها إنتل أول مرة في الأجهزة المحمولة عند طرح بيئة معالجات سنترينو، والآن هذه التقنية متاحة على الأجهزة المكتبية حيث تقوم بخفض سرعة المعالج حتى النصف في الفترات التي يخف فيها الضغط، وبالتالي توفر كما كبيراً من استهلاك الطاقة. أن جميع معالجات Core 2 تستخدم معدل طاقة منخفض مقارنة بالجيل السابق أو بمثلاتها AMD، حيث تفيد الاختبارات أن تقنية Speed step نجحت في تخفيض استهلاك الطاقة حتى 30% مما يعني حتماً درجة حرارة أقل وبالتالي حاجة أقل لمراسرعات عالية وصوت عالي.

سادساً: الممر الأمامي لنقل المعطيات FSB :

نلاحظ أن سرعة الممر أعلى في الكور 2 1066 فيما تبلغ 800 ميجاهرتز في بينتيوم دي، ومن المعروف أنه كلما ازدادت سرعة الممر كلما ازدادت سرعة نقل المعلومات في النظام وبالتالي ازداد الأداء وهنا أيضاً تبلغ الزيادة مقدار 33% عن الجيل 1066 لتفعيل هذه الميزة وغالباً ما ستكون هذه اللوحة مزودة بشريحة إنتل 965، لكن إنتل طرحت معالجات جديدة بسرعة ممر مقدارها 800 ميجاهرتز وهو E4300 1.8

Intel Core i3 Processor .2

هو معالج مشابهة لمعالج Core 2 Duo ولكن الفرق بينهما أن الأخير يحتوي على شريحتين بداخله وخطين معالجة i3 فيحتوي على شريحتين بداخله (أي معالجين) وطبعاً مستوى متقدم من الذاكرة العشوائية ولكن بدون خاصية Turbo

i3 مع معالجات الجيل الثاني ، يمكنك الحصول على الميزات التالية التي بنيت في : . ® حزب التحرير التكنولوجيا يسمح لكل نواة معالج الخاص بك للعمل على اثنين من المهام في نفس الوقت. ذاكرة التخزين المؤقت بشكل حيوي تخصيص إنتل الذكية لكل معالج الأساسية على أساس حجم العمل ، مما يقلل بشكل ملحوظ الكمون وتحسين

Intel Core i5 Processor .3

يستخدم هذا المعالج Turbo boost technology مما يجعله يقوم بأداء ذكي أثناء تحرير الصور و مشاهدة الفيديو كما يمكن لهذا المعالج أن يقوم بعدة مهام بسهولة يمكننا من الحصول على إنتاجي .

ومن مميزاته :

- Turbo boost technology تزيد السرعة بشكل كبير.
- يتميز هذا المعالج بتعددية المهام مما يمكنه من إنجاز مهام عدة في
- يط.
- الوسائل الإعلانية : سهولة تحويل الفيديو و الصور إلى إشارات رقمية.
- : احصل على تحسين بنسبة 32% عي لمميزات اللعبة.

وهناك مميزات المزود بها هذا المعالج :

Quad Core Processing .1

تزودنا بأربع نوى كاملة من أجل التنفيذ في حزمة واحدة في المعالج مما يساعد نظام التشغيل والتطبيقات أن تقوم بأداء إضافي . وهذا يجعل المستخدمين يقومون بمهام عدة عبر أنواع عديدة من التطبيقات.

2. Intel Turbo Boost Technology

تزيد هذه التقنية تواتر المعالج بشكل ديناميكي مما يؤدي إلى زيادة الأداء أوتوماتيكياً عندما

3. 8Mb smart cache

يمكن المستوى الأخير من الخابية النوى الأربعة من الاتصال بالتطبيقات

4. Intel Core i7 Processor

يعتبر هذا المعالج ثورة في عالم الحوسبة لإحتوائه على أربع شرائح في داخله ولكن بـ 8 خطوط معالجة لذلك يظهر لك في نظام التشغيل أنه يحتوي على 8 أنوية بمعنى أن تكون لديك 8 أجهزة كمبيوتر في جهاز واحد وبالطبع يأتي هذا المعالج بمستوى متقدم من الذاكرة العشوائية وبنظام Turbo

ويعتبر i7 هو أحد المكتبية x86-64 ، أول معالج يعمل بتقنية Nehalem ويعتمد على عائلة core 2.

معمارية Nehalem المعتمدة في Core i7 هي معمارية مطورة عن معمارية Core 2 ولكن مع اختلاف واضح في ذواكرها وواجهات الدخل والخرج حيث صمم معالج Core i7 (chip) واحدة مع متحكم ذواكر عليها (سابقاً كان (وتقنية ربط نقطة لنقطة مع اللوحة الأم

Quick Path interconnect و تقنية the-hyper-front-side-bus threading وهي ميزة تعطينا السماحية بتفعيل 8 threads بنفس الوقت (أي يمكننا 8). على الرقاقة بحيث تتناسب مع النظام الجديد كما عدلت على نظام الذواكر والذواكر الخابية وهرمية توزيع

إن هذه الرقاقة تحوي 731 مليون ترانزستور مرتبة على مساحة مقدره بـ 263 بتقني 45 نانو متر بينما تحوي معالجات "AMD's native quacore Phenom" 463 مليون ترانزستور ضمن مساحة أكبر مقدره بـ 283 2 لأنها تعتمد تقنية 65 نانو متر Core i7.

تظهر النوى الأربع في معمارية Nehalem وحولها العناصر تسميها (uncore) التي تشغل قسم كبير من الرقاقة وتشغل الـ Shared L3 Cashe uncore هذه الذاكرة الخابية (L3 Cashe) هي المستوي الأخير في التوزع الهرمي للذواكر الخابية وأما المستويات الأخرى فهي:

- L1 Cashe ضمن كل نوية من النوى الأربعة بحجم 32 . ب لكل منها
- L1 data Cashe 32 . 8
- L2 Cashe 256 . 8 مجموعات مشاركة أيضاً
- خارج النوى يوجد L3 Cashe 8 .

الذاكرة المخبئية من المستوى الثالث تعمل كناقل أساسي للمعطيات بين النوى الأربعة كما تقنية perfetching لزيادة أداء الذواكر الخابية (وهذه التقنية تعتمد على معرفة عينة من الذاكرة المستخدمة ثم ملئ الذواكر الخابية بمعطيات لها علاقة مباشرة مع هذه العينة وبالتالي سيزيد عدد الصحيحة للذاكرة الخابية). Core i7 يستطيع الوصول للذاكرة الرئيسية بشكل سريع نتيجة لمتحكم الذواكر المتكامل الذي تملكه والذي يقوم بالتخلص من " من رقاقة إلى أخرى عندما يذهب ضمن الـ front

side bus إلى المتحكم الشمالي. كما قامت الشركة بدمج ثلاث أفنية داعمة

DDR3 رسمياً أعلى سرعة للذواكر تم الوصول إليه بدعم من Core i7

1066 ميغا هرتز وإن المعالجات الأقوى ضمن سلسلة Core i7 تتمكن من

1600 2000 ميغا هرتز. Core i7

أفنية ذواكر بتردد 1066ميغا هرتز يمكن أن تصل إلى إجمالي(25.6 غيغا بايت بالثانية) . 1333ميغا هرتز نصل إلى32GB بالثانية

1600 ميغا هرتز(38.4 غيغا بايت بالثانية) 2000ميغا هرتز (48

غيغا بايت بالثانية) بينما ف core 2 ووصلنا كحد أقصى إلى(12.8 غيغا بايت بالثانية).

يرتبط معالج core i7 مع الذواكر بثلاث أفنية ومع باقي النظام برابط سريع جداً) " يستطيع النقل بمعدل(25.6غيغا بايت بالثانية) يسمى بالـ Quick

front-side bus. QPI Path interconnect